

※常用接點焊接鉚合底材材料表：

底材材料	JIS	ASTM	密度 g/cm ³	熔點℃	IACS %
軋煉銅	C1100	C11000	8.91	1083	97
無氧銅	C1020	C10200	8.91	1083	97
磷脫氧銅	C1201	C12000	8.91	1083	90
銅鐵	C192	C19210	8.94	1083	85
黃銅 70/30	C2600	C26000	8.53	915	28
黃銅 65/35	C2680	C26800	8.5	905	24
黃銅 60/40	C2801	C28000	8.39	900	23
磷青銅	C5101	C51000	8.86	950	12
磷青銅	C5191	-	8.83	910	11
磷青銅	C5212	C52100	8.8	880	15
磷青銅	C5210	C52100	8.8	880	24
鉍銅	C1720	C17200	8.26	980	50
銅鎳	C7060	C70600	8.9	1100	11.5
銅鎳	C7150	C71500	8.96	1200	4.6
鋅白銅	C7350	C73500	8.82	1100	6.2
鋅白銅	C7521	C75200	8.73	1120	6
鋅白銅	C7541	C75400	8.72	1100	6.9
鋅白銅	C7451	C74500	8.7	1050	8.9
冷軋鋼板	SPCC	A366			

※各種銀焊料之特性及用途：

規格	特性及用途	備註
BAG-1 BAG-1A	含鎘(Cd)，不合環保規定。熔融溫度範圍狹小，故急熱，或徐熱均適合。	非環保
BAG-2	含鎘(Cd)，不合環保規定。熔融溫度範圍較廣，易作接縫不均一之焊接，作業時須盡可能急速加熱，以避免低熔點成份熔離。	
BAG-3	含鎘(Cd)，不合環保規定。用於耐熔性良好之不銹鋼焊接。因含有鎳(Ni)對於碳化鎢(WC)之潤濕性良好，熔融溫度範圍廣，但流動性並不佳。	
BAG-4	用於焊接碳化鎢(WC)，流動性較 BAG-3 為優。	環保材質
BAG-5 BAG-6	用於電機產品之焊接。亦使用於食品業。Ag-6 的熔融溫度範圍較廣，但流動性較 BAG-1 及 BAG-2 差。宜急速加熱，用於接縫較大或需要填補時。	
BAG-7	流動性及潤濕性均佳，熔點低，用於日用品及食品業，亦適合於為減低應力腐蝕而需低焊接溫度之鎳(Ni)合金及不銹鋼等之焊接。	
BAG-7A	含銀(Ag)45%較 BAG-7 少 11%，特性同 BAG-7。	
BAG-7B	除熔融溫度範圍廣外，有與 BAG-7 相同的特性。	
BAG-8	只含銀(Ag)72%，銅(Cu)28%兩種成分，不含高蒸氣壓性之成份，用於焊接電子管及高真空機器，適合於不使用助熔劑之氣氛爐內焊接。使用於銅合金，流動性雖佳，但對於鋼鐵材料之潤濕性不佳。	
BAG-8A	含鋰(Li)，於高純度乾燥氣氛中使用，尤其對析出硬化型及其他不銹鋼之焊接頗有利。鋰(Li)對於不易焊接之金屬可促進潤濕，有助於改進流動性，鋰(Li)對於含少量鈦(Ti)或鋁(Al)之母材特別有效。	
BAG-18	含錫(Sn)有助於不銹鋼或鎳(Ni)合金，碳鋼之流動性改善。液相線溫度較 BAG-8 低，餘與 BAG-8 相似，於不使用助熔劑之焊接，應用於階段焊接。	
BAG-20	潤濕性及流動性均佳，但其焊接溫度較(1)(2)(3)含銀(Ag)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鎘(Cd)之焊料為高。此焊料之焊接性佳，而且銀量少，非常經濟實用。	
BAG-20A	銀(Ag)含量少(29~31%)之焊料，但熔點、焊接溫度均高，須注意母材之過熱。	
BAG-21	用於析出硬化合金及不銹鋼，不含鋅(Zn)及鎘(Cd)，特別適合於氣氛爐內之焊接，若焊接溫度高，焊接方法適當，則不需助熔劑。焊接宜用高溫，流動緩慢。	
BAG-24	低熔點且流動性佳，使用於食品業及醫療業等之不銹鋼焊接。亦使用於碳化鎢(WC)之焊接。	